

Lutowie ołowiowe ALPHA HiFlo® SMG Sn63Pb37

- wyjątkowo niska ilość generowanych żużli, mniej niedolotów, zwarć i „sopli”
- idealne dla gęsto obsadzonych pakietów
- umożliwia wysoką prędkość lutowania
- przeznaczone do lutowania elementów fine pitch

Opis produktu

Lutowia HiFlo® SMG produkowane są z najczystszych metali, w oparciu o opatentowane technologie służące obniżeniu lepkości stopu i ilości tworzących się żużli. W efekcie uzyskuje się lutowie lepszej płynności, które jedynie w niewielkim stopniu wykazuje tendencję do tworzenia żużli, nie zawiera zanieczyszczeń ani tlenków.

Charakterystyka i zalety

- *większa prędkość lutowania:* większa wydajność procesu lutowania i obniżone koszty produktu
- *mniejsza ilość generowanych żużli:* mniejsze zużycie lutowia, niższe koszty
- *mniej mostków:* mniej poprawek i niższe ich koszty, mniej błędów lutowania
- *lutuje gęsto obsadzone pakiety*
- *lutuje w niższych temperaturach:* wolniejsze tworzenie się żużli, zmniejszone zużycie lutowia i niższe koszty

Zastosowanie

Ołowiowe lutowie HiFlo® SMG znajduje zastosowanie w procesach lutowania maszynowego, także w atmosferze azotu. W szczególności nadaje się do:

- lutowania w tyglach zanurzeniowych i agregatach z falą (pojedynczą i podwójną)
- do cynowania powierzchniowego systemem HAL
- lutowania elementów fine pitch i płytek gęsto upakowanych

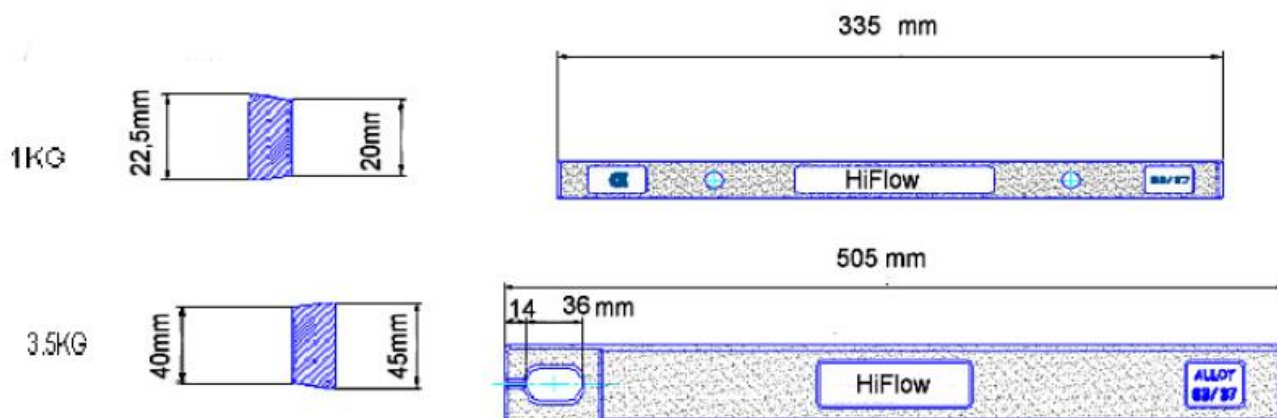
Zalecana temperatura lutowia w tyglu wynosi 255-270°C. Wyboru odpowiedniego topnika do procesu lutowania na fali można dokonać w oparciu o broszurę *SelectorGuide*.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

Przed zastosowaniem spoiwa HiFlo® SMG należy zapoznać się z *Kartą charakterystyki* i stosować się do zaleceń w niej zawartych.

Dostępność

Spojwa HiFlo® SMG są dostępne w postaci lasek o wadze 1kg lub gąsek z otworem o wadze ca 3,5kg.



Poziom zanieczyszczeń

Poniższa tabela zawiera typowe wartości zanieczyszczeń lutowi **HiFlo® SMG** w porównaniu do norm J-STD-006A, ISO9453 i JIS Z3282.

Metal	HiFlo® SMG	ISO 9453 stop 1A	J-STD-006A Sn63Pb37C	JIS Z3282E H63E
Sn	62,5-63,5%	62,5-63,5%	62,5-63,5%	62,5-63,5%
Pb	reszta	reszta	reszta	reszta
Sb	max. 0,05%	max. 0,05%	max. 0,05%	max. 0,05%
Cu	max. 0,005%	max. 0,05%	max. 0,08%	max. 0,05%
Zn	max. 0,001%	max. 0,001%	max. 0,003%	max. 0,001%
Fe	max. 0,001%	max. 0,02%	max. 0,02%	max. 0,02%
As	max. 0,005%	max. 0,03%	max. 0,03%	max. 0,03%
Ni	max. 0,002%	b.d.	max. 0,01%	b.d.
Bi	max. 0,005%	max. 0,05%	max. 0,10%	max. 0,05%
Cd	max. 0,001%	max. 0,002%	max. 0,002%	max. 0,002%
Ag	max. 0,005%	b.d.	max. 0,10%	b.d.
Al	max. 0,001%	max. 0,001%	max. 0,005%	max. 0,001%
In	max. 0,005%	b.d.	max. 0,10%	b.d.

Producent: Cookson Electronics Assembly Materials, Forsyth Road, Sheerwater Woking, Surrey GU21 5RZ, W. Brytania

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich uwarunkowań w jakich mogą być użyte nasze produkty, powyższe dane zawierają jedynie typowe wartości i nie są specyfikacją. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia prób z naszymi produktami przed ich wdrożeniem do produkcji.

Dystrybutor w Polsce: LENZ - Urządzenia dla elektroniki, 43-100 Tychy, tel. (32) 227 28 06, www.lenz.com.pl

AM_c_Sn63Pb37_w1_2011